



第IV栏

摘要正文(续第1页第5项)

一种延性电路制作方法，采用“卷对卷”式工艺，包括：(S1)将导电层和第一辅助基底层合形成一体后制成卷材，将该卷材的一端作为初始进料放卷端，放卷后展开设定长度；(S2)在展开设定长度的卷材导电层上进行图案化，制备所需的电路结构；(S3)将设置有第一辅助基底的第一弹性体层作为进料端，送入对辊，将电路结构转印到第一弹性体层表面，再将第一辅助基底层去除；(S4)采用对辊压合和粘力差，将芯片与电路结构组装在一起，获得延性电路层半成品；(S5)将第二弹性体层转印至延性电路层半成品表面，第二弹性体层用于延性电路层半成品的封装层。该方法通过将制作延性电路的工艺与卷对卷运动平台相结合，提高延性电路的生产效率。

<p><b>A. 主题的分类</b></p> <p>H05K 3/20(2006.01)i; G06K 19/07(2006.01)n</p> <p>按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类</p>																										
<p><b>B. 检索领域</b></p> <p>检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)</p> <p>H05K, H01L, G06K</p> <p>包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献</p> <p>在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))</p> <p>CNXTX;CNABS;DWPI;CNKI:卷对卷, 辊对辊, 卷, 辊, 芯片, 管芯, 电路, 密封, 封装, 柔性, 弹性, 压, 图案, 图形, 转印, 转移, 导电, 对准, 剥, Roll to roll, roller, R2R, chip?, die?, packag+, encapsulat+, seal+, pattern+, flexible, press, transfer+, print+, conduct+, bond+, foil, peel, reel</p>																										
<p><b>C. 相关文件</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型*</th> <th>引用文件, 必要时, 指明相关段落</th> <th>相关的权利要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PX</td> <td>CN 107222974 A (华中科技大学) 2017年 9月 29日 (2017 - 09 - 29) 全文</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>US 2010075459 A1 (KERR 等) 2010年 3月 25日 (2010 - 03 - 25) 说明书第[0073]-[0088]段, 附图5、6A-6D</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 101308953 A (汤献维) 2008年 11月 19日 (2008 - 11 - 19) 说明书第7页第8段到第11页第3段, 附图1</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>CN 103140953 A (POSCO公司) 2013年 6月 5日 (2013 - 06 - 05) 说明书第[0019]-[0081]段, 附图1, 4</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 104718797 A (日东电工株式会社) 2015年 6月 17日 (2015 - 06 - 17) 全文</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>CN 101002312 A (株式会社半导体能源研究所) 2007年 7月 18日 (2007 - 07 - 18) 全文</td> <td>1-6</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2011047793 A1 (KLINK 等) 2011年 3月 3日 (2011 - 03 - 03) 全文</td> <td>1-6</td> </tr> </tbody> </table>			类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求	PX	CN 107222974 A (华中科技大学) 2017年 9月 29日 (2017 - 09 - 29) 全文	1-6	Y	US 2010075459 A1 (KERR 等) 2010年 3月 25日 (2010 - 03 - 25) 说明书第[0073]-[0088]段, 附图5、6A-6D	1-6	Y	CN 101308953 A (汤献维) 2008年 11月 19日 (2008 - 11 - 19) 说明书第7页第8段到第11页第3段, 附图1	1-6	Y	CN 103140953 A (POSCO公司) 2013年 6月 5日 (2013 - 06 - 05) 说明书第[0019]-[0081]段, 附图1, 4	1-6	A	CN 104718797 A (日东电工株式会社) 2015年 6月 17日 (2015 - 06 - 17) 全文	1-6	A	CN 101002312 A (株式会社半导体能源研究所) 2007年 7月 18日 (2007 - 07 - 18) 全文	1-6	A	US 2011047793 A1 (KLINK 等) 2011年 3月 3日 (2011 - 03 - 03) 全文	1-6
类型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求																								
PX	CN 107222974 A (华中科技大学) 2017年 9月 29日 (2017 - 09 - 29) 全文	1-6																								
Y	US 2010075459 A1 (KERR 等) 2010年 3月 25日 (2010 - 03 - 25) 说明书第[0073]-[0088]段, 附图5、6A-6D	1-6																								
Y	CN 101308953 A (汤献维) 2008年 11月 19日 (2008 - 11 - 19) 说明书第7页第8段到第11页第3段, 附图1	1-6																								
Y	CN 103140953 A (POSCO公司) 2013年 6月 5日 (2013 - 06 - 05) 说明书第[0019]-[0081]段, 附图1, 4	1-6																								
A	CN 104718797 A (日东电工株式会社) 2015年 6月 17日 (2015 - 06 - 17) 全文	1-6																								
A	CN 101002312 A (株式会社半导体能源研究所) 2007年 7月 18日 (2007 - 07 - 18) 全文	1-6																								
A	US 2011047793 A1 (KLINK 等) 2011年 3月 3日 (2011 - 03 - 03) 全文	1-6																								
<input checked="" type="checkbox"/> 其余文件在C栏的续页中列出。		<input checked="" type="checkbox"/> 见同族专利附件。																								
<p>* 引用文件的具体类型:</p> <p>“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件</p> <p>“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利</p> <p>“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)</p> <p>“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件</p> <p>“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件</p>		<p>“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了解发明之理论或原理的在后文件</p> <p>“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性</p> <p>“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性</p> <p>“&amp;” 同族专利的文件</p>																								
<p>国际检索实际完成的日期</p> <p>2018年 3月 27日</p>		<p>国际检索报告邮寄日期</p> <p>2018年 4月 4日</p>																								
<p>ISA/CN的名称和邮寄地址</p> <p>中华人民共和国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088</p> <p>传真号 (86-10)62019451</p>		<p>授权官员</p> <p>车晓璐</p> <p>电话号码 (86-10)62089965</p>																								

C. 相关文件		
类型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	JP 10178255 A (KYOCERA CORP) 1998年 6月 30日 (1998 - 06 - 30) 全文	1-6

国际检索报告  
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2017/112770

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN	107222974	A	2017年 9月 29日	无	
US	2010075459	A1	2010年 3月 25日	US	8361840 B2 2013年 1月 29日
				EP	2329522 A2 2011年 6月 8日
				WO	2010036307 A3 2010年 8月 19日
				WO	2010036307 A2 2010年 4月 1日
CN	101308953	A	2008年 11月 19日	无	
CN	103140953	A	2013年 6月 5日	JP	2013546156 A 2013年 12月 26日
				EP	2595211 A2 2013年 5月 22日
				EP	2595211 A4 2014年 7月 16日
				CN	103140953 B 2016年 8月 3日
				JP	5879343 B2 2016年 3月 8日
				KR	101147988 B1 2012年 5月 24日
				WO	2012008683 A2 2012年 1月 19日
				US	2013105203 A1 2013年 5月 2日
				KR	20120006844 A 2012年 1月 19日
				WO	2012008683 A3 2012年 5月 3日
CN	104718797	A	2015年 6月 17日	JP	2014075253 A 2014年 4月 24日
				EP	2906023 A4 2015年 11月 18日
				US	2015255746 A1 2015年 9月 10日
				EP	2906023 A1 2015年 8月 12日
				WO	2014054622 A1 2014年 4月 10日
				KR	20150064019 A 2015年 6月 10日
				TW	201419619 A 2014年 5月 16日
CN	101002312	A	2007年 7月 18日	KR	101254277 B1 2013年 4月 15日
				KR	20070046855 A 2007年 5月 3日
				WO	2006011665 A1 2006年 2月 2日
				CN	100530575 C 2009年 8月 19日
				US	9053401 B2 2015年 6月 9日
				US	2008042168 A1 2008年 2月 21日
				JP	2006066899 A 2006年 3月 9日
				JP	4749074 B2 2011年 8月 17日
				US	2015287660 A1 2015年 10月 8日
US	2011047793	A1	2011年 3月 3日	US	8198135 B2 2012年 6月 12日
				US	2008076209 A1 2008年 3月 27日
				DE	102006044525 B3 2008年 1月 31日
JP	10178255	A	1998年 6月 30日	JP	3495211 B2 2004年 2月 9日